

**DOWA**

**2009年度第1四半期  
決算補足資料**

**2009年7月30日**

**DOWAホールディングス株式会社**

# 2009年度第1四半期の総括

## ■ 金属価格、為替の影響

|       |       | '08-4Q実績 | '09-1Q実績 | '09前提条件 |
|-------|-------|----------|----------|---------|
| 為替    | 円/\$  | 93.7     | 97.3     | 95.0    |
| 銅     | \$/t  | 3,426    | 4,660    | 4,200   |
| 亜鉛    | \$/t  | 1,173    | 1,473    | 1,350   |
| インジウム | \$/kg | 333      | 309      | 350     |

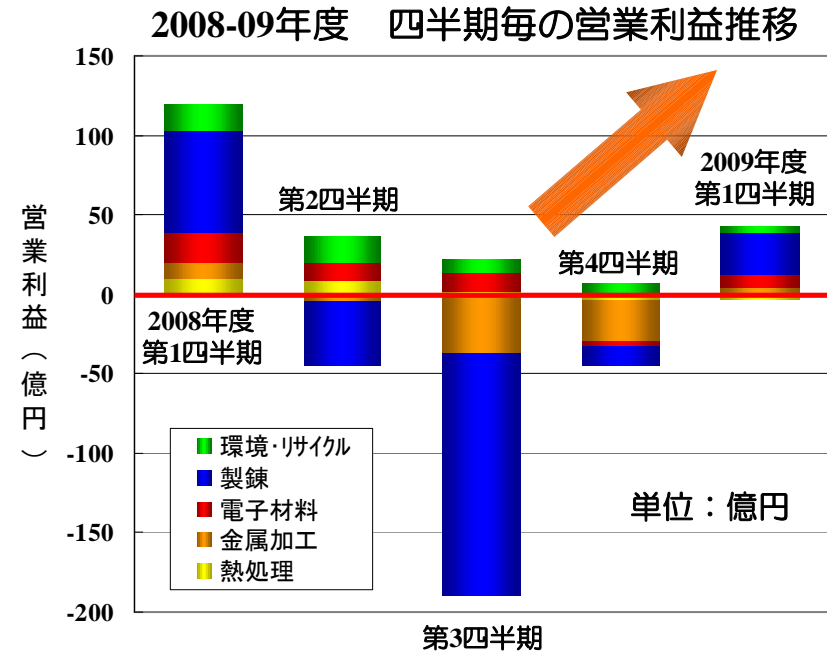
- ◆ 金属価格、為替は概ね前提条件を上回って推移  
第1四半期に発生した時価・簿価差と低価法および為替の影響は+18億円

## ■ マーケット状況

- ◆ エレクトロニクス関連、車載電装品関連では、前年4Qを底に需要が急回復  
6月には前年上期比70~80%の生産水準、中でも銀粉は太陽電池向け販売増も加わり、過去最高の生産量に
- ◆ 一方、環境関連、工業炉などの設備投資関連は回復鈍い

## ■ コストダウン

- ◆ 各種施策を着実に実行 → 年間100億円の計画に対し、1Qで30億円を達成



# 構造改革の進捗状況

～低操業下でも利益の出せる体制へ～

## ■拠点再編

- ・ 電子材料 フェライト粉生産拠点の集約  
⇒6月末にシンガポールからの事業撤退完了、生産を国内工場に集約
- ・ 金属加工 伸銅2工場の操業一体化による最適生産体制の構築  
⇒開発・生技部門の統合、一部銅合金の鋳造・仕上げ圧延を移管
- ・ 熱処理 生産効率の高い工場への集約  
⇒横浜工場での加工を太田工場へ移管、工業炉製造を3→1拠点へ

## ■人員計画 (DOWAグループ全体)

2008年3月末 5,600人 → 2009年3月末 5,000人 → 2009年6月末 4,880人 → 2010年3月末計画 4,700人

※ MAEH社の人員は除く

## ■コスト削減

|        |                   | 年間計画   | 1Q実績     |
|--------|-------------------|--------|----------|
| ・ 人件費  | 給与カット、賞与への業績反映など  | 60億円/年 | 15億円/3ヶ月 |
| ・ 経費節減 | 物品費削減、出張旅費規程見直しなど | 10億円/年 | 6億円/3ヶ月  |
| ・ 操業改善 | エネルギーコスト、修繕費圧縮など  | 30億円/年 | 9億円/3ヶ月  |

# 主要製品 生産量/処理量実績(増減率)

|              |         | 前年同期比  |        |        | 2008年度上期比 |        |        | 前年4Q比    |
|--------------|---------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|----------|
|              |         | 2008年度 |        |        | 2008年度    |        | 2009年度 | 2009年度   |
|              |         | 上期実績   | 3Q実績   | 4Q実績   | 3Q実績      | 4Q実績   | 1Q実績   | 1Q実績     |
| 環境・<br>リサイクル | 廃棄物処理量  | △0.8%  | △4.0%  | △19.0% | △1.0%     | △16.4% | △9.1%  | ➡ +8.8%  |
|              | 花岡土壌処理量 | △16.7% | △25.9% | △42.8% | +32.5%    | +5.2%  | △11.1% | △15.5%   |
| 製<br>錬       | 金       | △66.4% | △28.9% | △58.3% | +24.5%    | △5.2%  | +84.8% | ⬆ +94.9% |
|              | 銀       | △57.7% | △18.8% | △31.4% | +11.4%    | +0.0%  | +31.4% | ➡ +31.4% |
|              | 銅       | △15.5% | +15.7% | △30.4% | △4.1%     | △10.1% | △35.2% | △28.0%   |
|              | 亜鉛      | △5.1%  | △16.5% | +3.0%  | △8.3%     | +10.0% | △0.2%  | △9.3%    |
| 電子材料         | 化合物半導体  | △6.1%  | △47.3% | △74.4% | △46.1%    | △74.1% | △48.7% | ⬆ +97.8% |
|              | LED     | △23.3% | △46.2% | △45.9% | △29.8%    | △44.5% | △27.4% | ➡ +30.8% |
|              | 銀粉      | +55.9% | △26.6% | △48.8% | △26.4%    | △49.8% | +5.6%  | ⬆ 2.3倍   |
| 金属加工         | 伸銅品     | +5.8%  | △27.3% | △82.8% | △26.3%    | △82.5% | △47.5% | ⬆ 3.0倍   |
| 熱処理          | 熱処理加工   | △5.7%  | △35.7% | △68.2% | △23.4%    | △61.3% | △52.0% | ➡ +24.1% |

※製錬部門は2008年度/1Qとの比較